

VMV Dimensioning System

3Dスナップショット技術による様々な対象物の寸法測定

SICK
Sensor Intelligence.



技術仕様概要

事業分野	配送、フルフィルメント 小包、郵便、貨物 倉庫の自動化
コンベアスピード	≤ 0 m/s ... 2 m/s (スタート/ストップ動作可能) (タイプによる)
対象物検出精度	± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm ... ± 10 mm x ± 10 mm x ± 5 mm
最小対象物寸法	40 mm x 40 mm x 10 mm ... 100 mm x 100 mm x 50 mm
最大対象物寸法	700 mm x 500 mm x 400 mm ... 1200 mm x 1000 mm x 800 mm
出力データ	Minimum Bounding Boxの最大寸法 (奥行き、幅、高さ), Minimum Bounding Boxの体積, .pngでの画像出力

製品説明

トラックアンドトレースシステムVMV Dimensioning Systemは、対象物の長さ、幅、高さを正確に測定します。静的プロセスにも動的プロセスにも適したシステムバリエーションが用意されています。3Dスナップショット技術では、測定プロセス内で3D点群が生成されます。これに基づいて、対象物の寸法、コーナー座標、回転角度が正確に測定されます。また、3DカメラはRGB画像も撮影し、結果を最適化して記録するために使用されます。半透明の表面など、要件が非常に高い対象物では、AIベースのソフトウェアモジュールを追加することも可能です。

概要

- 3D点群を作成するための3Dスナップショット技術
- AIベースのソフトウェアモジュール
- Safety Designerの入手方法
- RGB画像キャプチャ

メリット

- コンベア速度が変化する場合でも素早く寸法を測定
- 要件の高い対象物の寸法測定: 光沢性、黒色または半透明の表面、非常に平らな物体、容器に入った物体
- 迅速で容易な設置
- 位置と回転姿勢を検出し、下流のプロセスステップ (仕分けロボットなど) にデータを転送することによるプロセスオートメーション

使用範囲

- 静的および動的プロセスにおける対象物の寸法測定
- 下流プロセスの点検: 仕分け、コンテナ内の対象物の単一化、出荷ラベルの位置決め
- 容器内の物体を測定して、充填レベル点検およびはみ出し検知を実行
- 適切な搬送装置の決定
- 実際の製品寸法とERPシステムのデータを比較して対象物を検証

注文情報

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/VMV_Dimensioning_System

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.